

審尋

(June 2, 2009)

審判請求の番号	不服2007- 17340
(特許出願の番号)	(特願2002-320336)
起案日	平成21年 5月27日
審判長 特許庁審判官	宮坂 初男
請求人	株式会社日本触媒 様
代理人弁理士	安富 康男 (外1名) 様

この審判事件について、下記の点に対する回答書を、この審尋の発送の日から60日以内に提出して下さい。

## 記

この審判事件については、審査官による審査（特許法第162条、前置審査）の結果、以下の《前置報告書の内容》のとおり、特許をすべき旨の査定ができない旨の報告（同法第164条第3項、前置報告書）が特許庁長官になされました。この審判事件の審理は、今後、この《前置報告書の内容》を踏まえて行うことになります。

この審尋（同法第134条第4項）は、この審判事件の審理を開始するにあたり、《前置報告書の内容》について、審判請求人の意見を事前に求めるものです。意見があれば回答してください。

## (備考)

・この審尋は、拒絶理由の通知（同法第159条において準用する同法第50条）ではありません。したがって、この審尋の回答に際し、同法第17条の2に規定する補正をすることはできません。なお、拒絶査定理由と異なる拒絶理由があり、合議体が必要と判断した場合には、あらためて拒絶理由が通知され、同法第17条の2に規定する補正の機会が与えられます。

・以下の《前置報告書の内容》を検討した結果、この出願についての審判の手続継続の意思がなくなった場合には、審判請求を速やかに取り下げてください。

・回答がない場合であっても、審理において不利に扱うことはありませんが、合議体が審判の手続継続の意思について確認する場合があります。

審判部審判企画室 (e-mail: PA6B00@jpo.go.jp、又は電話03-3581-1101内線5851) までお問い合わせ下さい。また、この審尋の内容についてのご質問は、最後に記載された問い合わせ先をお願いいたします。

《 前置報告書の内容 》

前置報告書

審判番号	不服2007-017340
特許出願の番号	特願2002-320336
特許庁審査官	久保田 英樹 3776 4J00
作成日	平成20年 1月25日

この審判請求に係る出願については、下記の通り報告します。

記

- ・根拠条文 第29条第2項
- ・請求項 1-14
- ・引用文献等 1、3、4
- ・特許査定できない理由

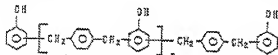
平成19年1月16日付け拒絶理由通知書で引用した、引用文献1の請求項1には、フェノール樹脂溶液中でシリコンアルコキシドの加水分解・重縮合を行わせて得られたフェノール樹脂とシリカとの複合体、及び該複合体をエポキシ樹脂の硬化剤とした、フェノール樹脂硬化エポキシ樹脂が記載されている。

また、フェノール樹脂硬化エポキシ樹脂中において、0.002-2 $\mu$ m径の微細なシリカ微粒子を均一に複合化できること（請求項5、【0017】等を参照）、該樹脂の使用に際しては、THF等の有機溶媒（本願発明における、エーテル結合構造を有する化合物に相当）を用いてゾル溶液とすること（【0015】、【0016】参照）、上記フェノール樹脂硬化エポキシ樹脂の硬化物は力学物性や耐熱性に優れ、IC封止材等の電気・電子部品あるいは機械部品の材料として有用であること（【0001】、【0005】参照）も記載されている。

ここで、本願明細書【0046】の記載からみて、フェノール樹脂溶液中でシリコンアルコキシドの加水分解・重縮合を行っている、引用文献1記載のフェノール樹脂-シリカ複合体中に含まれるシリカ微粒子のMAS-NMR測定を、本願明細書記載の条件で行えば、請求項4で規定される特定のプロファイルを示すものと認められる。

本願の請求項1ないし14に係る発明と引用文献1記載の発明とを対比すると、引用文献1には、フェノール樹脂の原料として、請求項1で規定される、炭素数が2以上の有機骨格を形成する化合物(1)ないし(5)を用いるとともに、フェノール性水酸基を1つ以上有する化合物と上記炭素数が2以上の有機骨格を形成する化合物との配合モル比を1.3/1以上で反応させることが記載されていない点で相違する。

しかしながら、エポキシ樹脂硬化剤として用いられるフェノール性水酸基含有の縮合物として、一般的なフェノール樹脂に比べ、芳香族炭化水素含有量が多い、フェノールアラルキル樹脂等の縮合物が、難燃性や耐熱性に優れることは周知であるか、周知とは言えないとしても、少なくとも今回新たに引用する引用文献3に記載された公知の技術であるし、 $\alpha$ 、 $\alpha'$ -ジアルコキシ-p-キシレン(本願発明における「(1)  $\alpha$ -アルコキシアルキル基を有する芳香族系化合物」に相当)に4モル以上のフェノールを反応(本願発明における「多価フェノール化合物を製造するときに用いる該フェノール性水酸基を少なくとも1つ有する芳香族骨格を形成する化合物と、該炭素数が2以上の有機骨格を形成する化合物との配合モル比は、1.3/1以上」に相当)させて得られる、下記一般式



( $n: 0 \sim 5$  でかつ  $n=0$  のものを50モル%以上含む)で示される低分子量フェノールアラルキル樹脂とすることで、流動性が向上しただけでなく、耐熱性や機械的特性に優れたエポキシ樹脂材料が得られる、今回新たに引用する引用文献4に開示されている。

半導体封止材料等の電気・電子材料分野において、難燃性や耐熱性の向上は当業者にとって自明な課題であるし、作業性を勘案すれば、材料の低粘度化も強く要求される課題といえる。

そうであるならば、引用文献1記載の発明において、一般的なフェノール樹脂に替えて、引用文献4記載の低分子量フェノールアラルキル樹脂を用いることは当業者が容易に想到することであるし、そのことによる効果も引用文献3及び4の記載から予期し得る程度のことに過ぎない。

よって、請求項1ないし14に係る発明は、当業者が引用文献1、3及び4に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。

#### 引用文献等一覧

- 特開平09-216938号公報(特に、請求項1、【0001】、【0005】、【0015】-【0017】を参照)

参照)

4. 特開昭63-238129号公報（特に、特許請求の範囲1、2、第1頁右欄第7-14行、第3頁右上欄第5行-左下欄第15行を参照）